

uvat

UVAT Technology Co.,Ltd.

友威科技股份有限公司

股票代碼：3580

友威科技 營運簡報

2021/12/22

投資人關係聯絡方式：

E-mail：theresachen@uvat.com



免責聲明

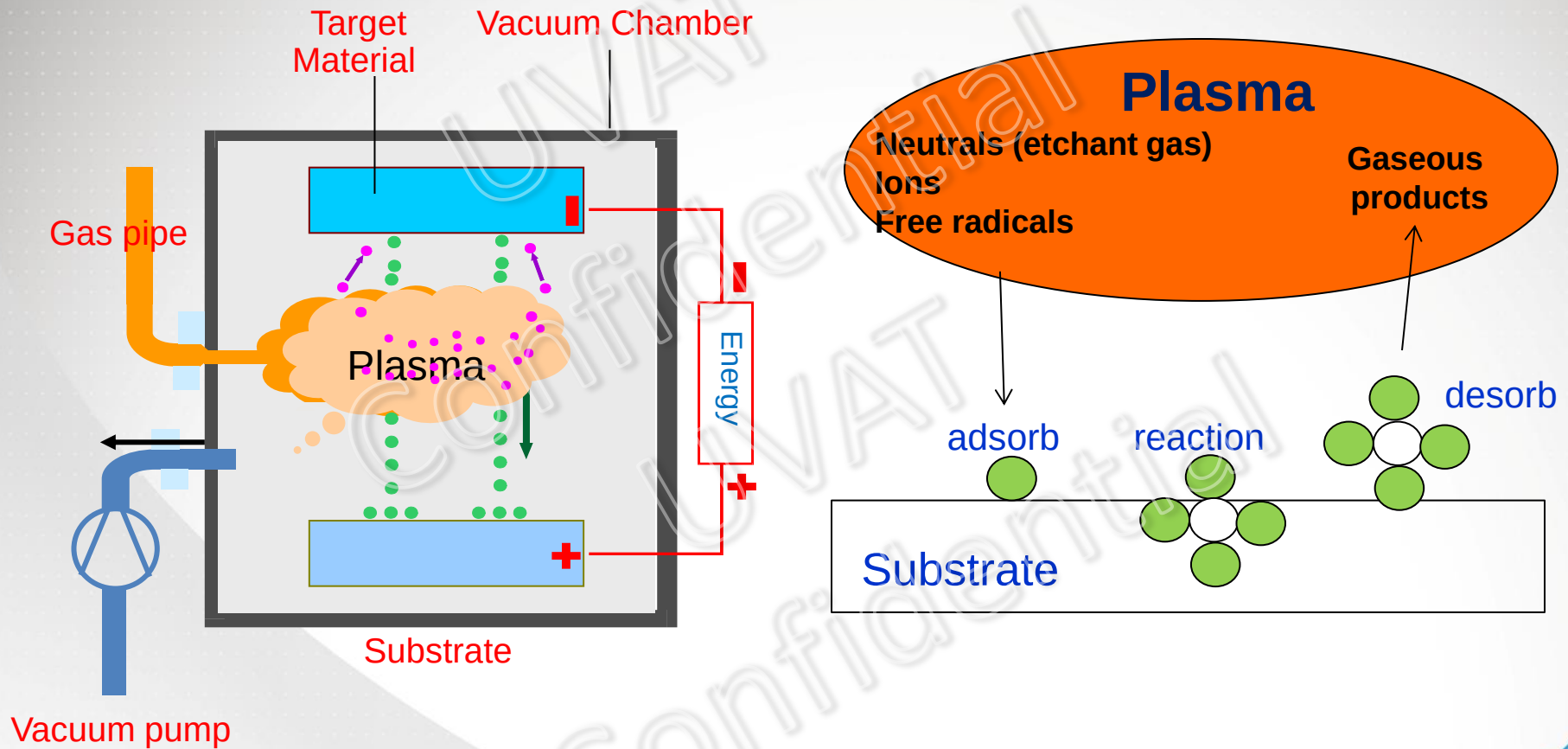
■本簡報及同時發布之相關訊息所提及之預測性資訊，包括營運展望、財務狀況及業務預測等內容，係本公司基於內部資料及外部整體經濟發展現況所得之資訊。

■本公司未來實際產生之營運結果、財務狀況與業務成果，可能與預測性資訊有所差異，其原因可能來自各種因素，包括但不限於市場需求、價格波動、競爭情勢、國際經濟狀況、匯率波動，以及其他本公司無法掌控之風險等因素。

■本簡報中所提供之資訊，係反映本公司截至目前為止對未來之看法，並未明示或暗示性地表達或保證其具有正確性、完整性或可靠性。對於簡報內容，未來若有任何變更或調整，本公司不負責更新或修正。

■未經本公司允許情況下，不可複製、修改、重新編譯、刪減或傳送本簡報任何內容，或將任何該等內容作為商業用途。

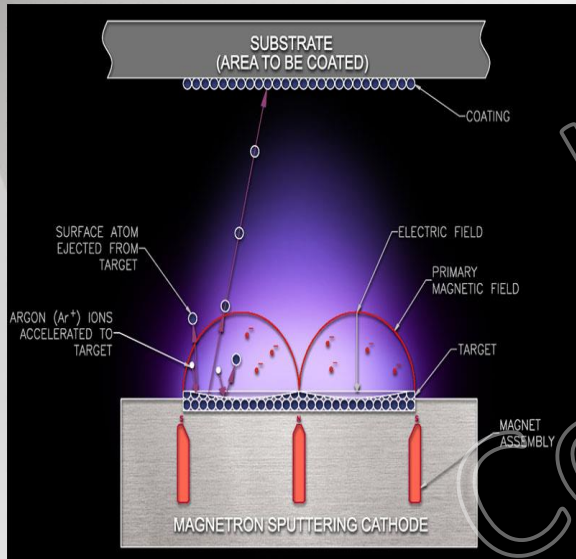
濺鍍Sputter / 電漿蝕刻Plasma Etch



PVD

a thin coating

on to a substrate



- PVD (Physical Vapor Deposition) 物理氣相沉積
- Vacuum Metallization (VM) 真空金屬化
- Sputtering 濺鍍
- Evaporation 蒸鍍

會議議程

1

公司簡介

2

應用領域

3

半導體應用

4

經營實績

5

未來展望



公司簡介

關於友威

成立時間	2002/11/04
董事長暨總經理	李原吉
資本額	新台幣3億9,470萬
員工	台灣：120人 中國：約450人
服務項目	真空濺鍍設備 蝕刻設備 半導體設備及相關耗材 鍍膜代工 光學鍍膜 薄膜元件

- ❖ 2007年股票公開發行
- ❖ 2010年7月9日股票上櫃(友威科3580)

據點介紹

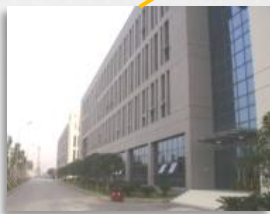


❖ **總公司**
■ 台灣桃園廠

❖ **研發中心**
■ 台灣台中廠

❖ **真空鍍膜代工廠**
■ 台灣桃園廠
■ 中國深圳廠
■ 中國昆山廠
■ 中國重慶廠

❖ **真空鍍膜設備製造**
■ 台灣台中廠



重大事蹟

2019

榮獲中華民國
第42屆創業楷模暨創業相扶獎



2021

榮獲第六屆中堅企業

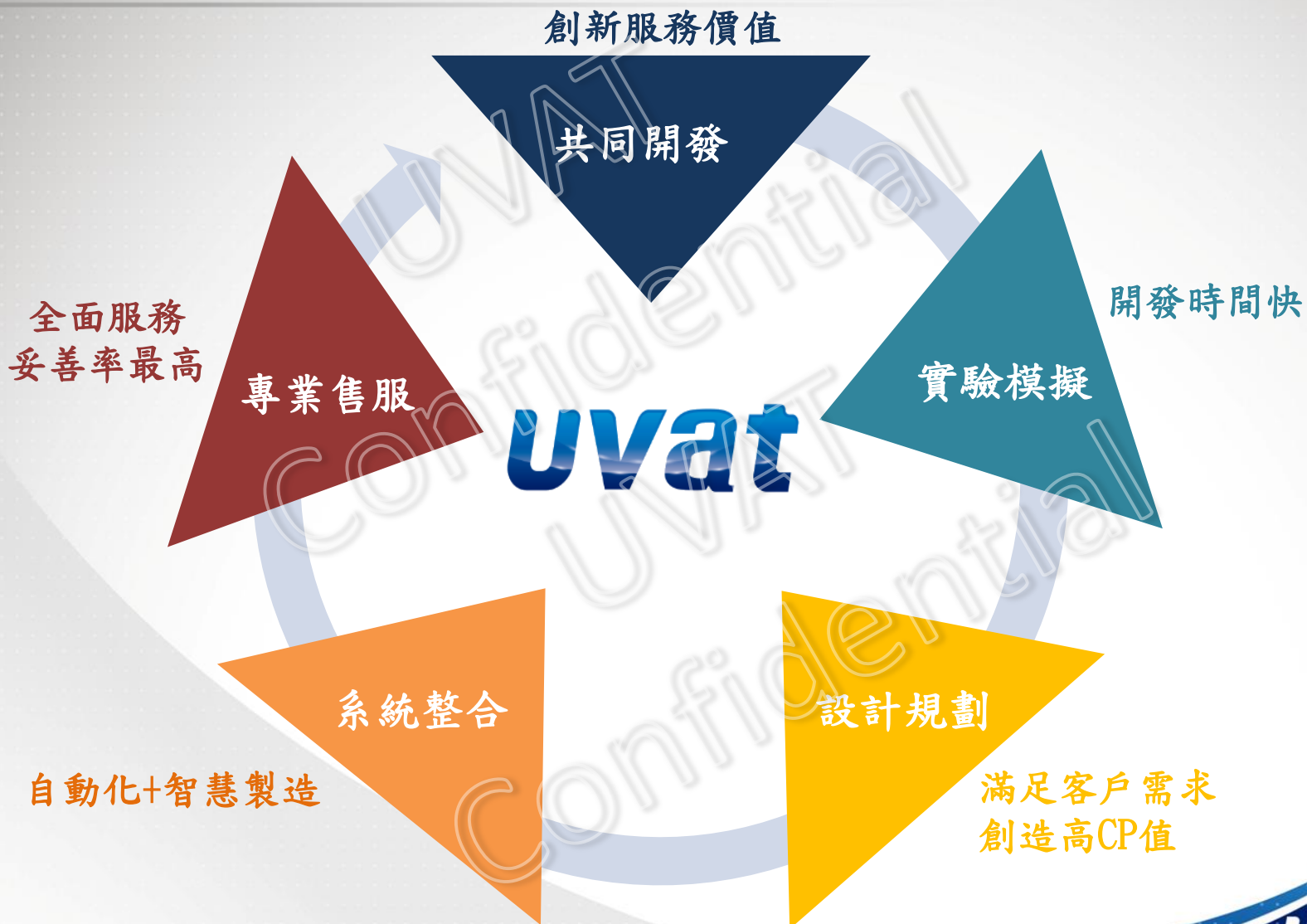


2021

榮獲第28屆中小企業創新研究獎



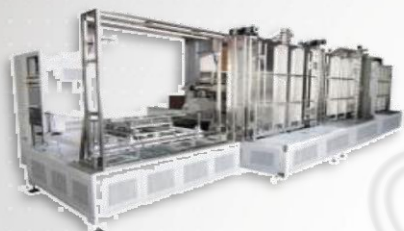
經營策略



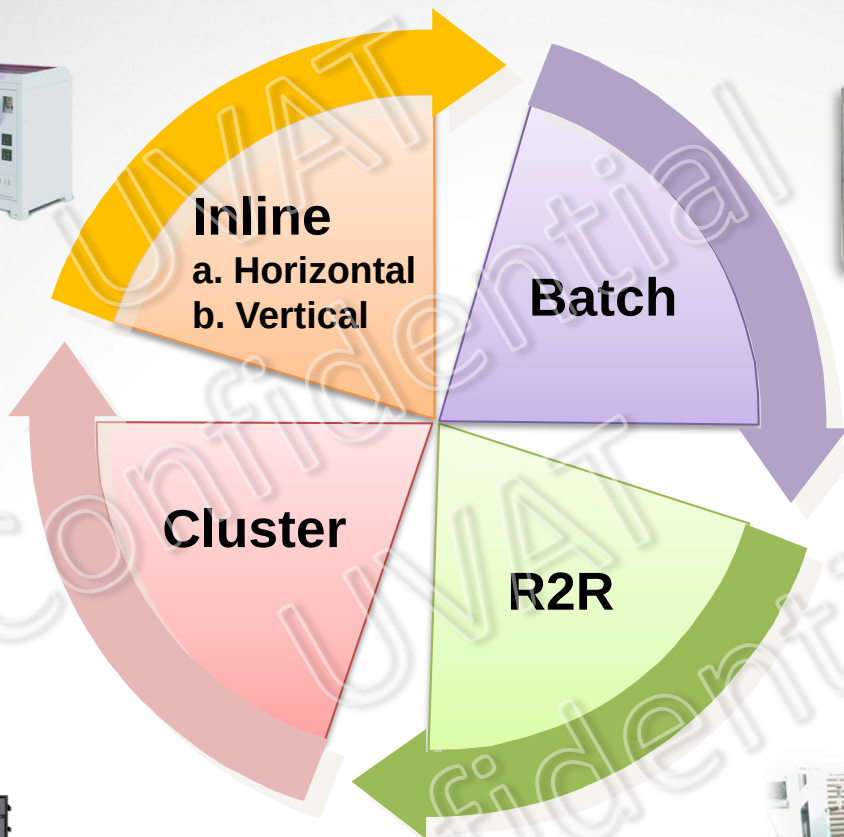
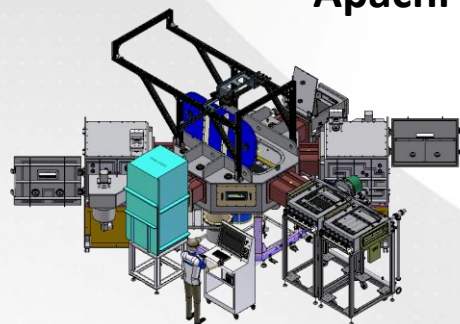
濺鍍機型



Apollo



Apachi



Inline
a. Horizontal
b. Vertical

Batch

Cluster

R2R



Arena



In-Line Sputter



Sputter Material : Metal 、 Oxide 、 Nitride
Substrate Material : PMMA 、 PET 、 PC 、 Glass
Tact time : **60sec** ~ depends on film thickness
Foot-Print : L 13m x W 2.5m x H 2.5m



Batch 爐式

蝕刻 Dry Etch Equipment

- Panel level plasma treatment



- High speed dielectric etch



- High aspect ratio plasma descum



- Fine pitch metal etch





應用領域

主要市場



汽車



消費性
電子



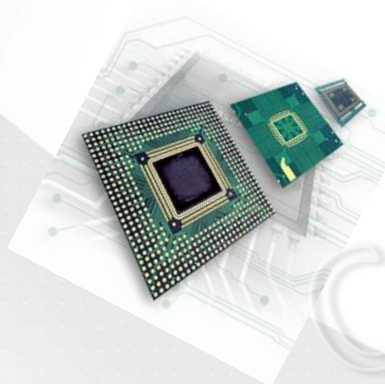
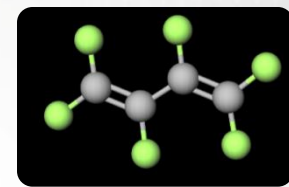
光學
產業



被動元件



石英產業



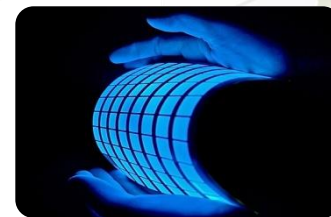
IC 載板
電路板



半導體封裝



晶片內埋



Car



Display /HUD/Lens



鋁鏡、鉻鏡、藍鏡
液晶鏡、光學半透鏡



Logo/內飾件

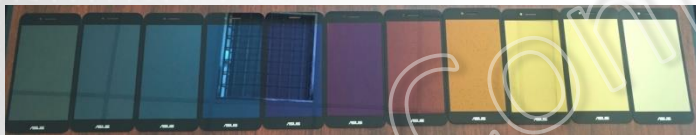


汽車輪圈

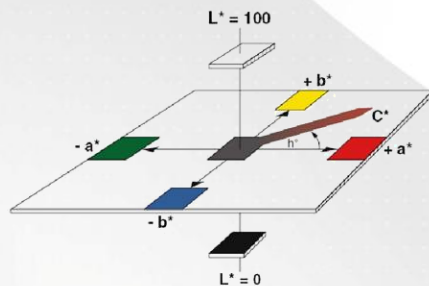


氣門嘴

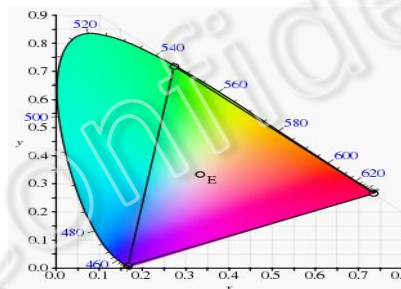
光學產業 Optical Coating



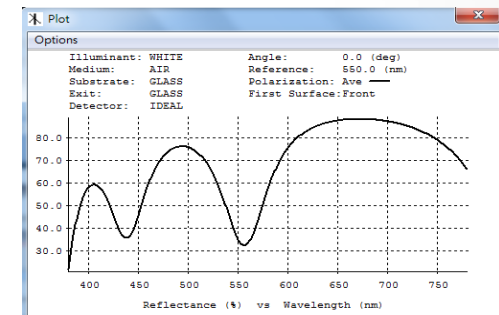
Color Coordinate



CIE Color Position



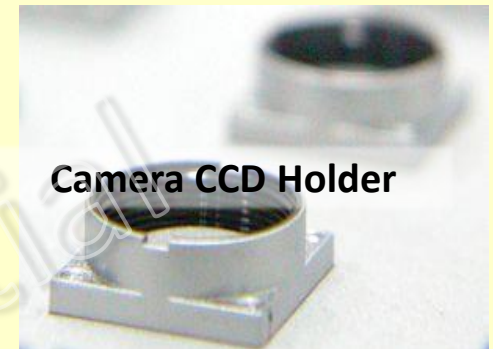
Simulation



Mobile & NB

Application

SDC	Keypad, Housing, Lens, Ring
EMI	Mobile, NB, CCD Holder, Chip EMI, GPS
NCVM	Mobile Housing, Lens, Bluetooth Headset
NMVM	Keypad, Lens, NB, GPS



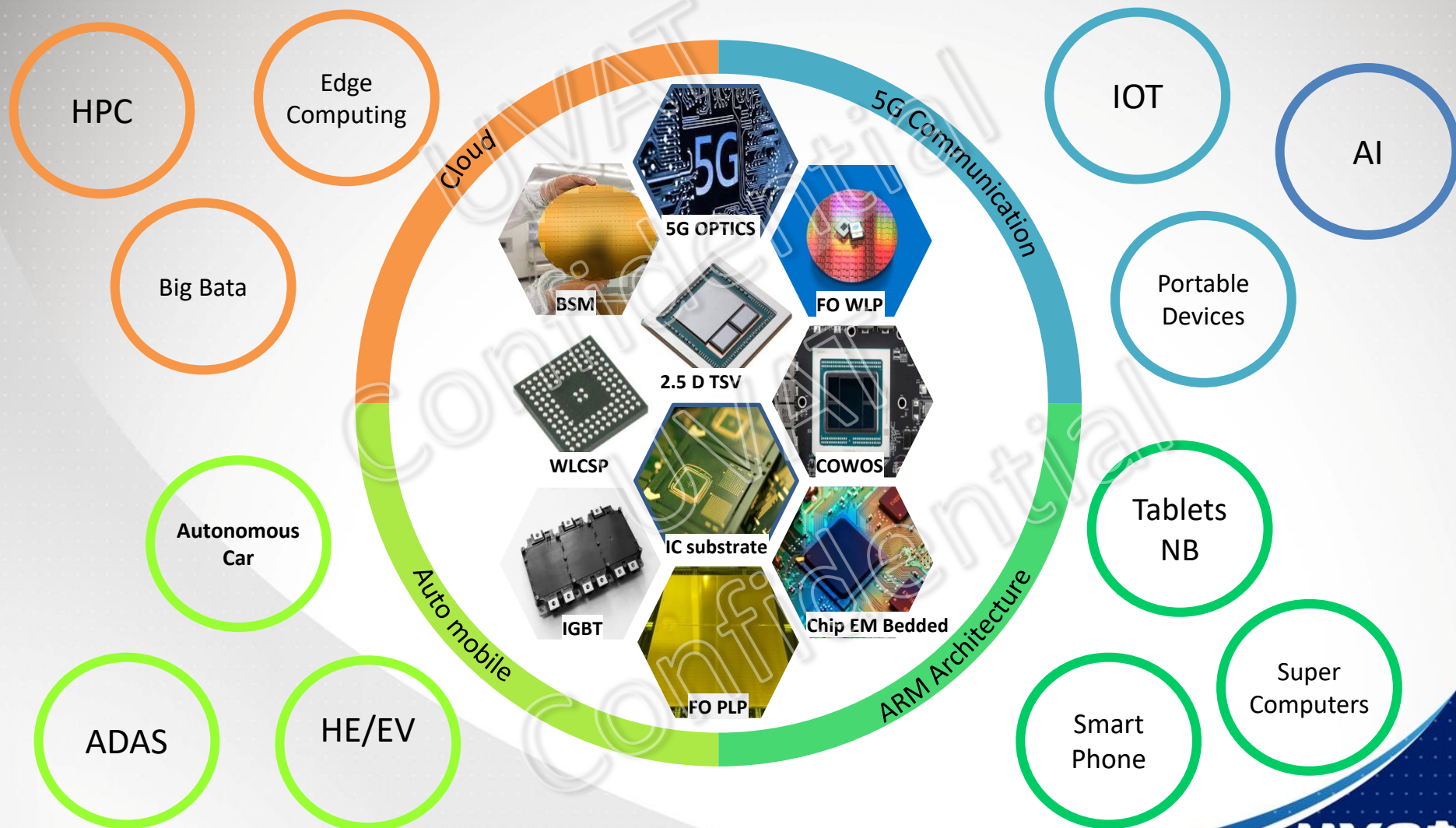
鍍膜代工

- NB EMI
- 光學鏡頭EMI
- BT 載板鍍膜
- 手機背蓋光學鍍膜
- 汽車光學鍍膜

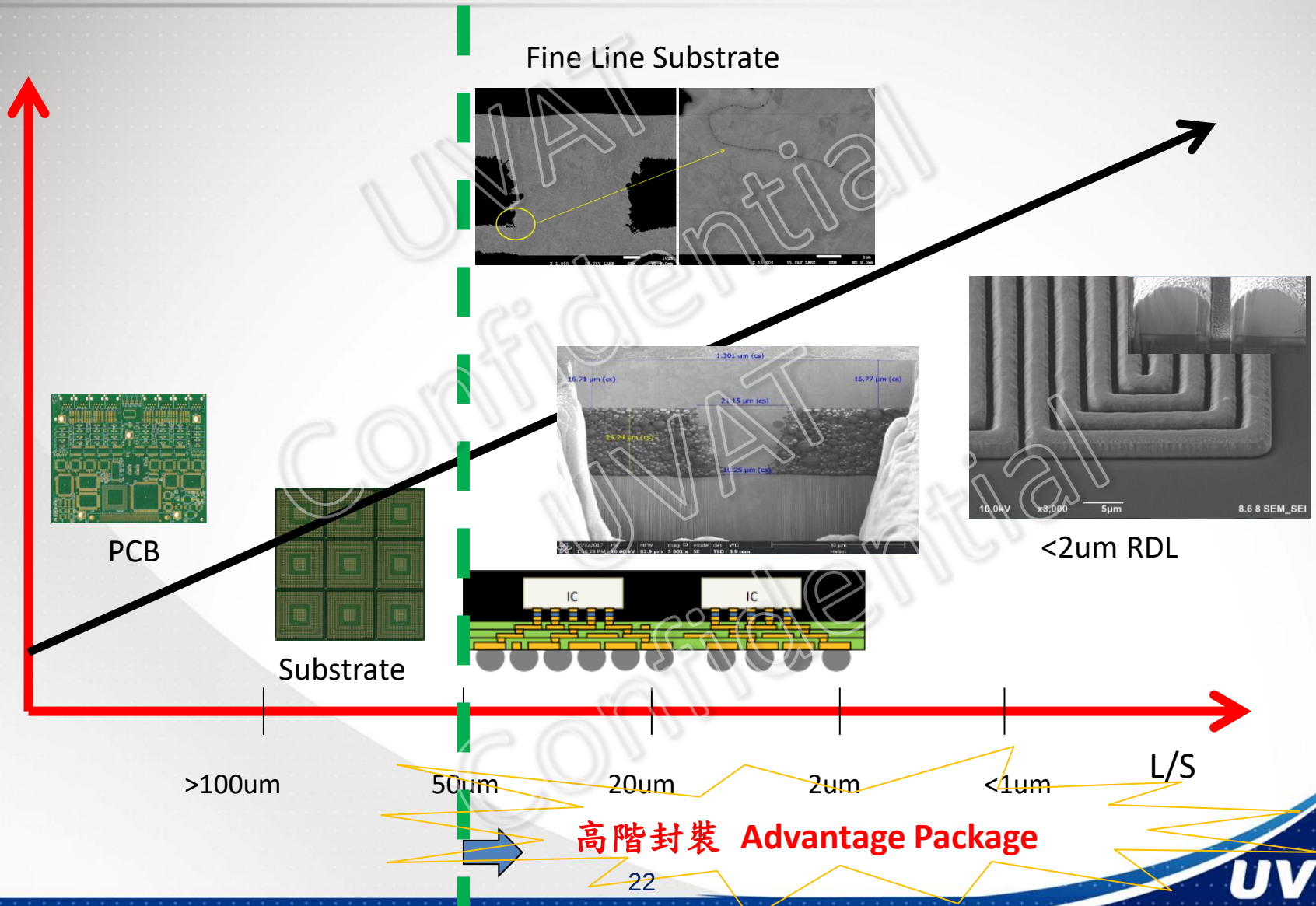


半導體應用

From Application to Product



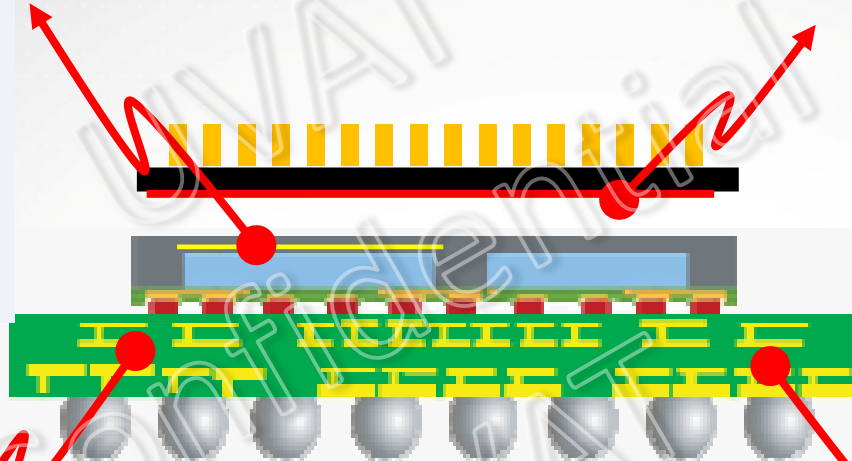
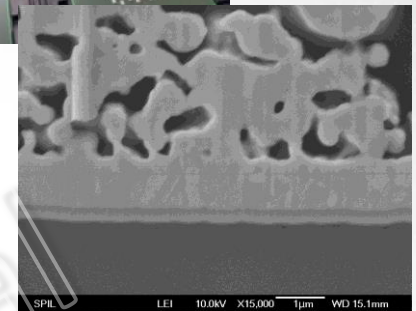
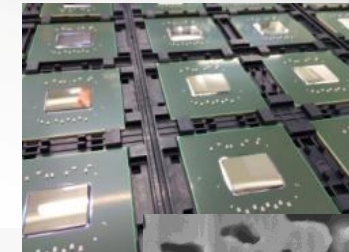
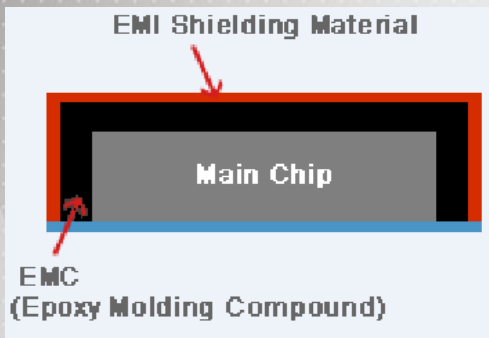
Line/Space Evolution in Semiconductor



Four Arrows in IC Advanced Package

SIP EMI

Thermal Dissipation



Plasma Etcher

材料: PID,PR,ABF

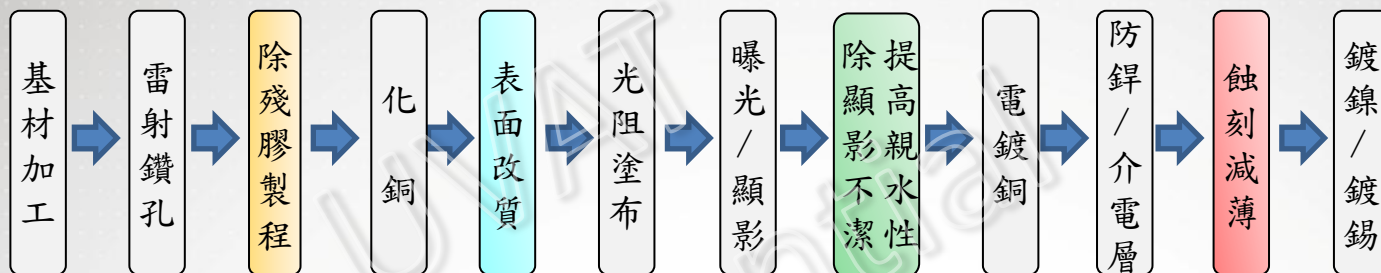
U%< 10%

High Aspect Ratio Etch

Seeding Sputter

ABF/EMC/PID

乾式電漿蝕刻_高階載板



PE-01 Series



表面改質

提高親水性

設備特性 (Wetting)

連續式大產能生產模式
電鍍化銅前Plasma Wetting
可搭配收放料板機自動化

PE-02 Series



除殘膠製程

除顯影不潔

設備特性 (Descum)

低溫製程能力
高深寬比電漿特性
(High Aspect Ratio)
細線路製程能力 (Fine line)

PE-03 Series



蝕刻減薄

設備特性 (Thin Down)

大產能高速蝕刻能力
低基材變形量 (Warpage)
介電材厚膜減薄能力
(Thin Down 5~100um)

PE-07 Series



表面改質

提高親水性

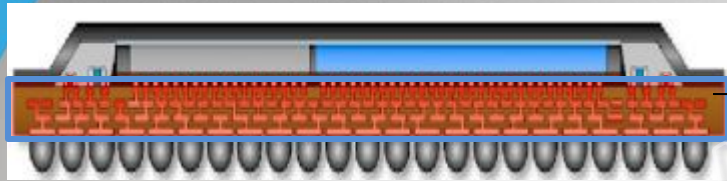
除殘膠製程

除顯影不潔

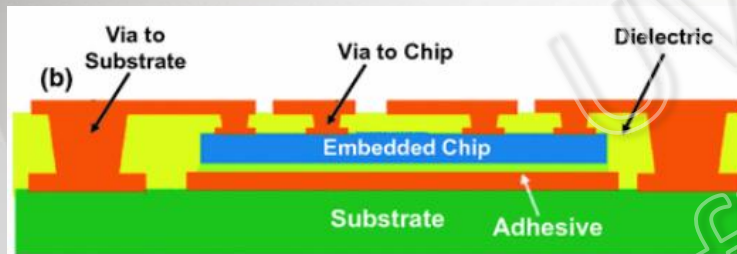
設備特性 (Descum Dual)

單面Descum 功能
雙面Wetting 功能
適用於多種材料應用系統

Plasma Equipments for FOPLP



RDL &
metallization



Chip embedded
package

- RDL Seedlayer Metal Sputter



- Panel level plasma treatment



- High speed dielectric etch



- High aspect ratio plasma descum



- Fine pitch metal etch

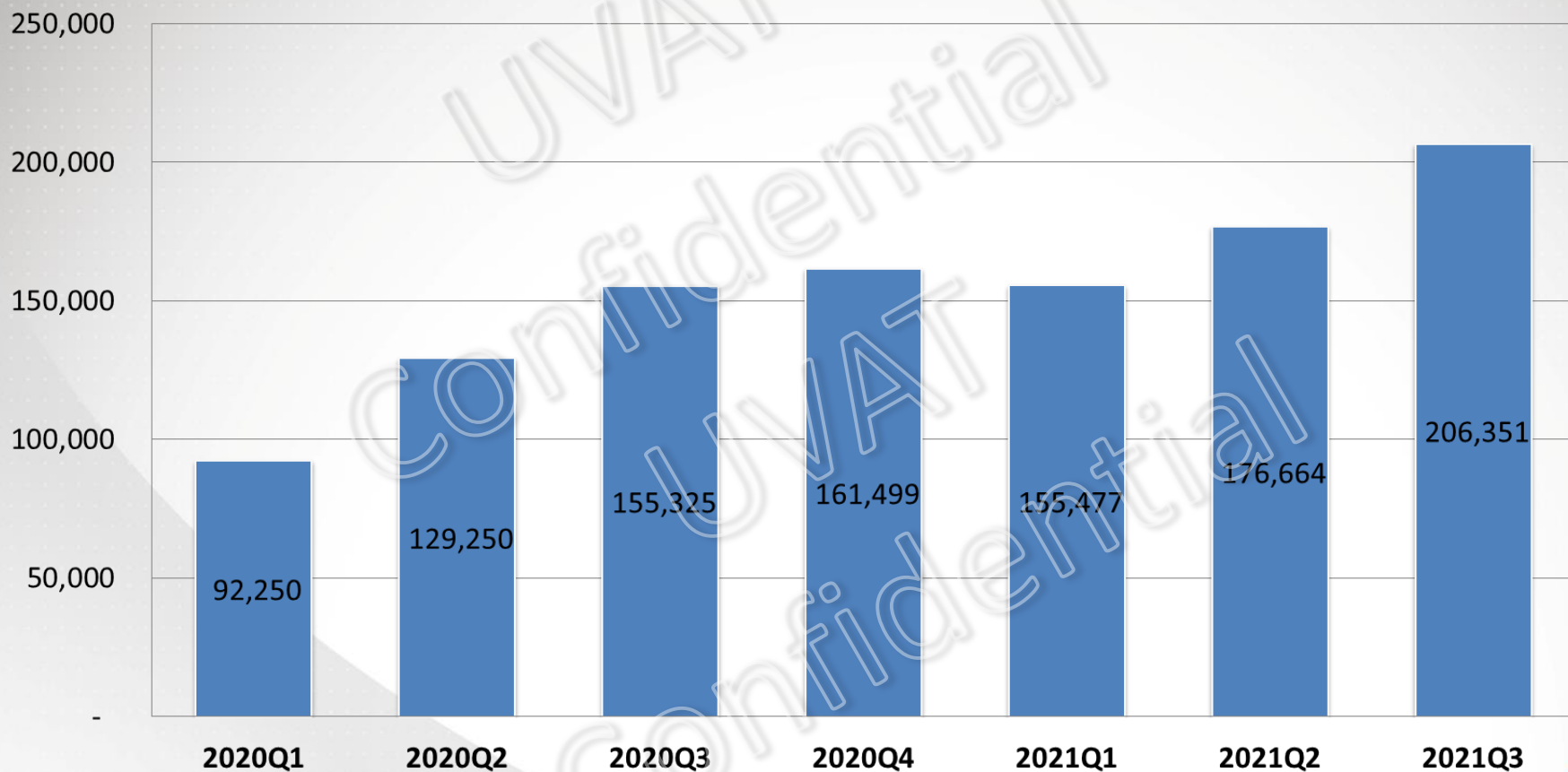




經營實績

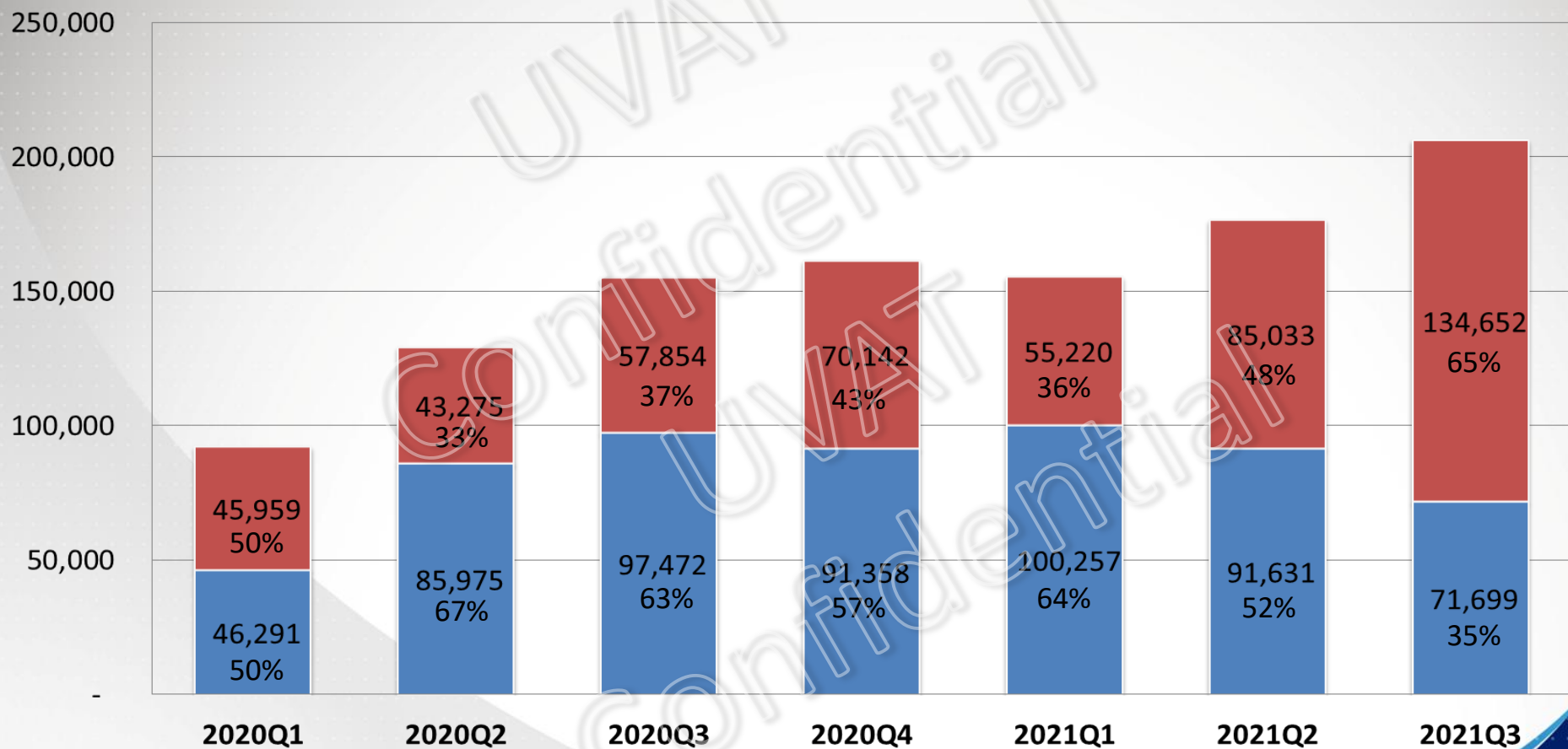
2020~2021Q3各季收入趨勢

單位：NTD仟元



2020~2021Q3各季收入分類

單位：NTD千元



■ 代工 ■ 設備

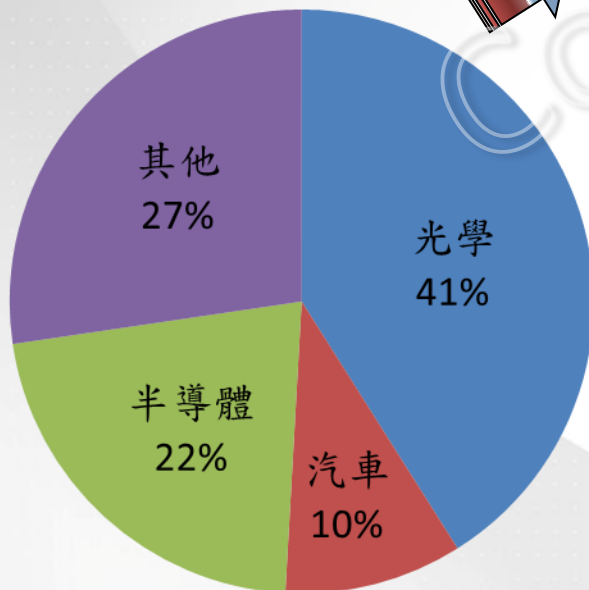
2019~2021Q3簡明損益表

單位：EPS為新台幣元，
其餘為新台幣仟元

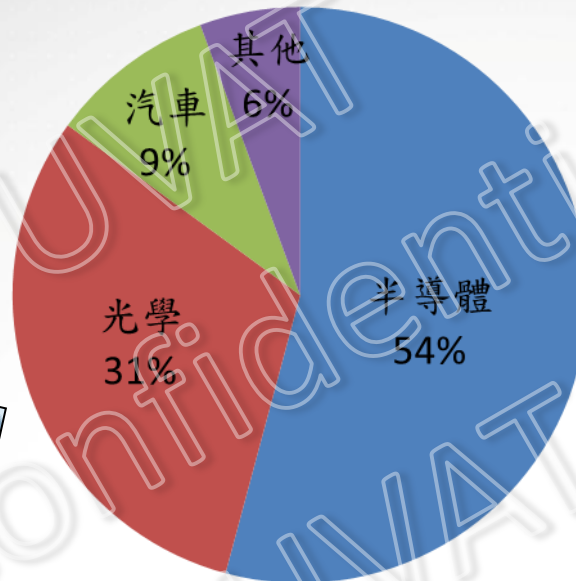
年度	2019	%	2020	%	2021Q3	%
營業收入	750,362	100%	538,325	100%	538,492	100%
營業成本	482,816	64%	360,743	67%	331,707	62%
營業毛利	267,546	36%	177,582	33%	206,785	38%
營業費用	159,150	21%	126,879	24%	108,401	20%
營業淨利	108,396	14%	50,703	9%	98,384	18%
稅前淨利	116,991	16%	76,553	14%	90,698	17%
稅後淨利	94,751	13%	70,772	13%	74,196	14%
EPS	2.43		1.84		1.93	

2019~2021Q3設備營收分布趨勢

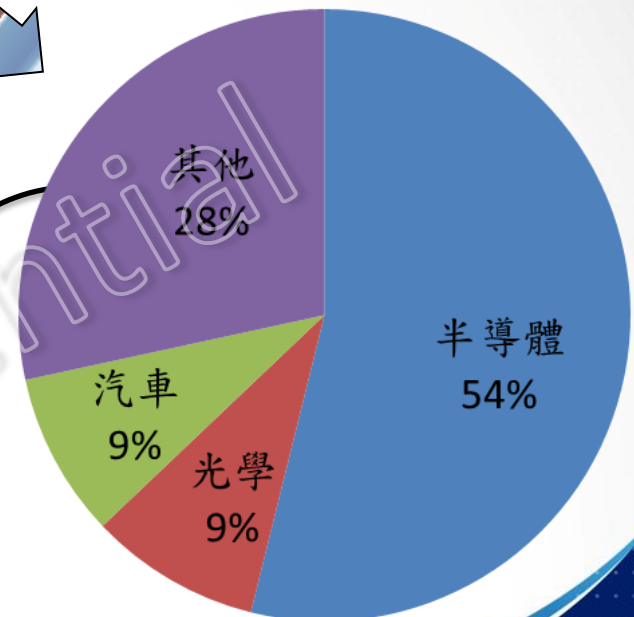
2019年度



2020年度



2021年Q3

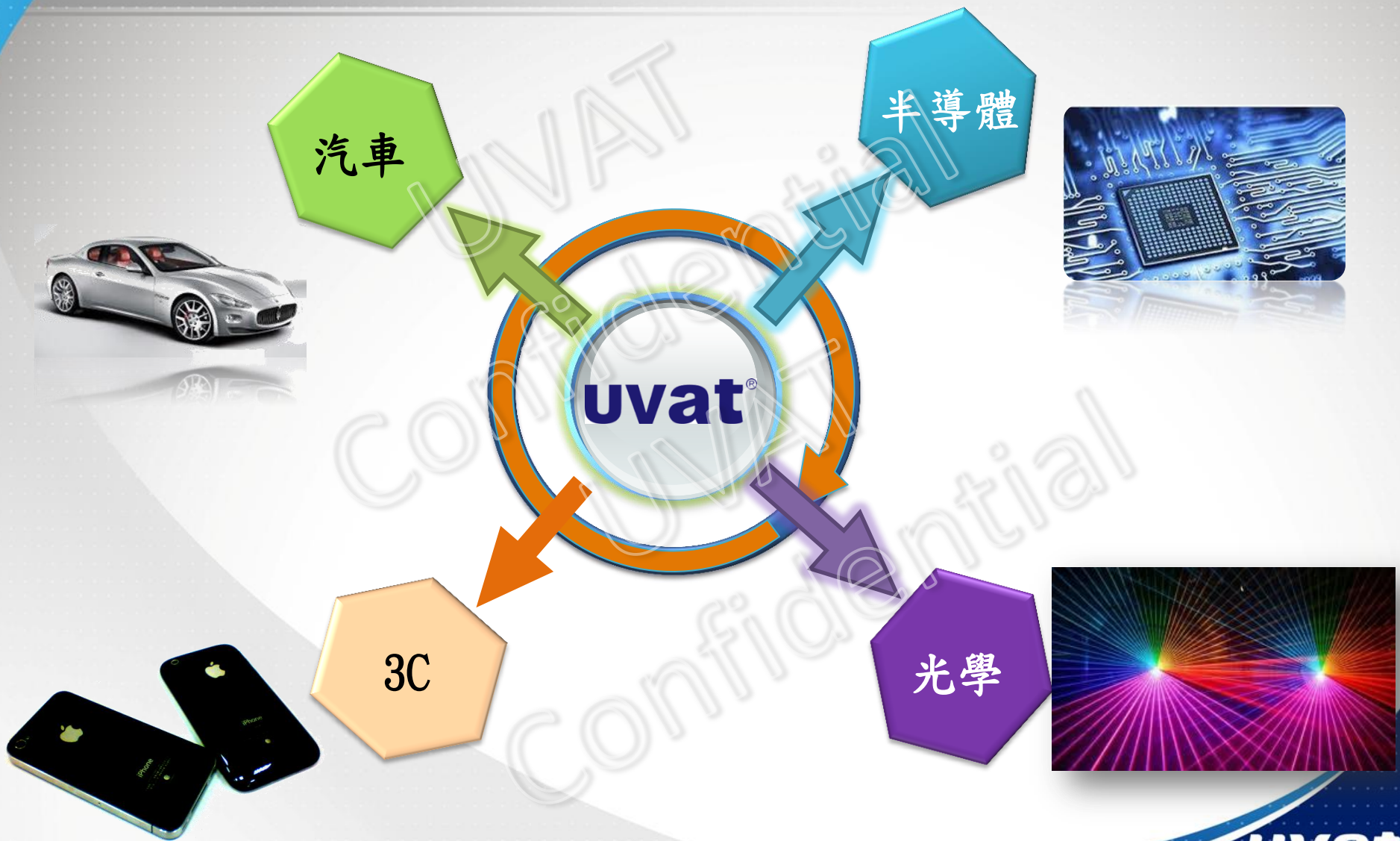


其中13%為被動元件



未來展望

未來主要市場



2022營收組合目標

項目	成長幅度	2022目標營收佔比	2021推估營收佔比
濺鍍設備			
半導體設備及耗材	發展主軸，金額大幅成長	30%~35%	27%~30%
光學	大幅成長	25%~30%	8%~10%
汽車	持平	3%左右	4%~6%
其他	持平	10%~15%	10~13%
濺鍍代工			
代工	減少	25%~30%	40%~45%

The background is a deep blue gradient with numerous out-of-focus white and light blue circles of varying sizes, creating a bokeh effect. A bright, white, starburst-like light source is positioned in the upper left quadrant, casting rays of light across the scene.

uvvat

UVAT Technology Co.,Ltd.

~ Thank You ~